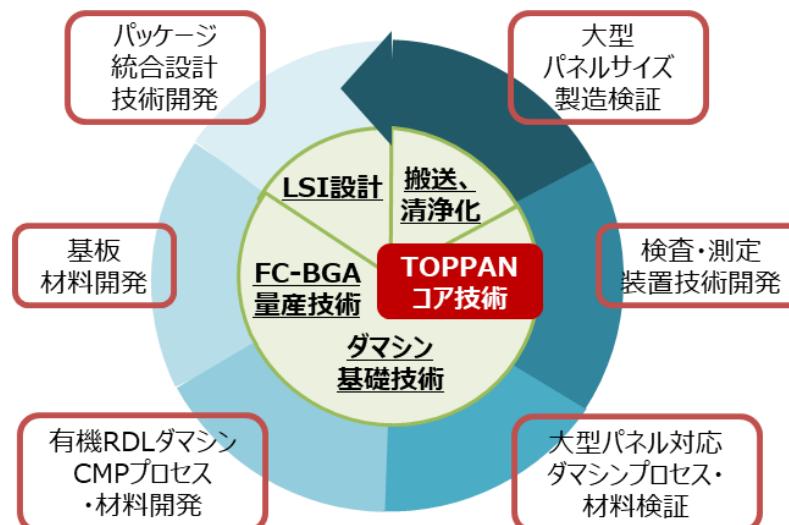


次世代チップレット向けサブミクロン有機RDLインターポーラーの設計・製造技術開発

実施者	TOPPAN株式会社
概要	<p>ポスト5G情報通信システムが目指すAIの世界的普及には、劇的なデータ処理・通信量の拡大が求められるとともに、それに伴う消費電力増大も懸念されている。この両者の課題解決に寄与する次世代チップレット構造の実現に向け、本事業では510×515mmパネル型の有機材料に対し、前工程に由来するダマシンCMP工法適用によるサブミクロン配線製造技術を確立し、大容量伝送（大型化・微細配線）と低消費電力化を両立する有機RDLインターポーラーを開発する。</p>

世界初の取り組みとして、500mm角以上のパネルフォーマットにてダマシンCMP工法を適用したLine/Space=0.5/0.5μmの大型インターポーラーの社会実装を目指す

■本事業における6つの開発領域

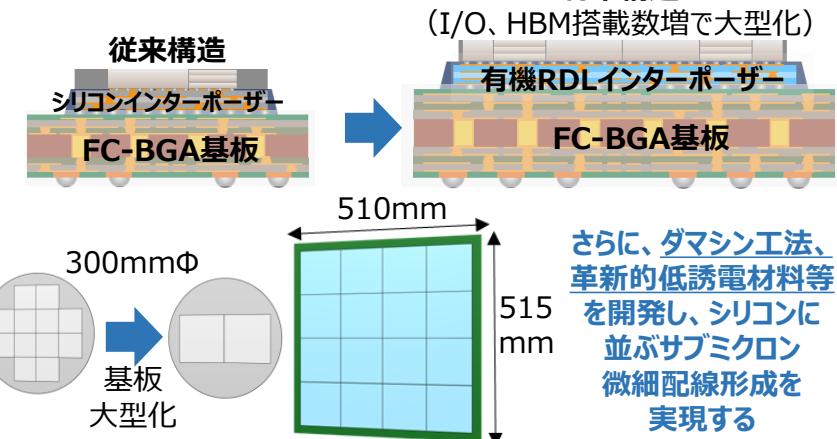


共同研究先
公立大学法人大阪 大阪公立大学、国立大学法人東京科学大学、
公立大学法人富山県立大学、国立大学法人信州大学、
国立研究開発法人産業技術総合研究所

■開発内容

- ・サブミクロン有機RDLインターポーラーの設計、プロセス・材料、検査、実装等周辺技術の開発
- ・510mm×515mmの大型パネルを適用した、サブミクロン有機RDLインターポーラーのパイロットラインによる製造検証

将来構造



既存のウェハチップレットは大型化で取れ数大幅減
⇒大型パネル基材適用で生産性確保